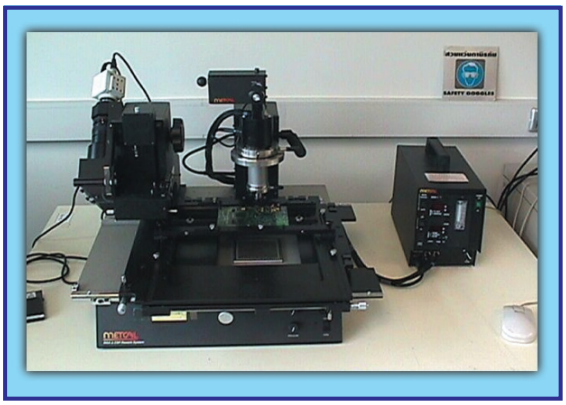
ให้บริการเชื่อม IC แบบ BGA ลงบนแผ่นวงจร

สวทช NSTDA

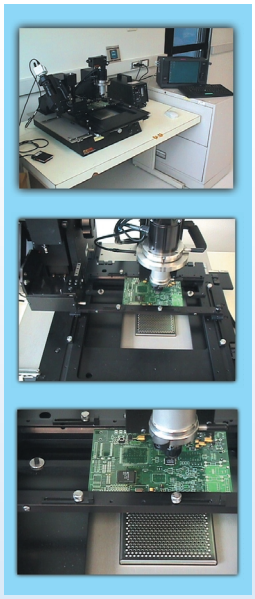
NECTEC
Electronic • Computer • Telecommunication • Information

ในปัจจุบัน IC (Integrated Circuit) ชนิดใหม่ๆ ที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ มักจะเป็นแบบ BGA (Ball Grid Array) เพื่อลดขนาดของอุปกรณ์ลง และการเชื่อมต่อ IC ดังกล่าวลงบนแผ่นวงจรนั้น เพื่อความถูกต้องและแม่นยำจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง จึงทำให้เครื่องมือดังกล่าวมีราคาที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยที่ต้องการทำต้นแบบเพียงไม่กี่ชิ้น ความแม่นยำในการประกอบ IC มีความสำคัญอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าวทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมงานวิจัยภายในประเทศ จึงเปิดให้บริการเชื่อมต่อ IC แบบ BGA เข้ากับแผ่นวงจรให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งควบคุมดูแลโดยทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ



วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยภายในประเทศ
2. แบ่งปันเครื่องมือซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงสู่การใช้งานที่กว้างขวาง และเป็นประโยชน์มากขึ้น
3. ลดการนำเข้าเครื่องมือดังกล่าวที่เกินความจำเป็น



แผนการดำเนินงาน

สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ หรือเอกชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

BGA-3000 SYSTEM SPECIFICATIONS

- ขนาดใหญ่สุดของ PCB (Maximum PCB Dimensions) 16"x OpenFrame
- ความหนาของ PCB (PCB Thickness) 0.031"–0.125"
- ขนาดใหญ่สุดของ IC (Maximum Component Dimension) 1.77"x1.77"
- น้ำหนักมากสุดของ IC (Maximum Component Weight) 1.92oz (0.55 kg)
- ชนิดของ IC (Component Types): BGA, QFP, PLCC, TSOP, SOIC

RDT1 งานวิจัยระบบสื่อสารไร้สาย
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

www.nectec.or.th/info/posters/

ลงวันที่ พ.ศ. 2545 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ห้ามคัดลอก หรือนำไปผลิตซ้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901..3
http://www.nectec.or.th/ e-mail: info@nectec.or.th

BT105-45
6 มิถุนายน 2545